

## 概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。本節內容僅為概要，並未載列可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下決定[編纂][編纂]前，務請閱讀整份文件。任何[編纂]均存在風險。[編纂][編纂]的若干具體風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節。

### 概覽

我們是光電互連產品提供商，提供光模塊、有源光纜（「AOC」，其將光模塊及光纖纜線集成為單一組件以實現高速互連）及其他產品。我們的光電互連產品廣泛應用於AI數據中心，以支持高速、高密度及高能效的數據傳輸。我們憑藉建立從芯片設計到光模塊製造的端到端技術能力實現差異化競爭，並專注於硅光子（「硅光子」）技術領域。

我們的光模塊產品組合涵蓋100G、200G、400G及800G傳輸速率，兼容多種行業標準外型規格。所有400G及以上規格的單模光模塊均採用硅光子技術。我們的AOC及其他產品線可滿足客戶多樣化需求，在產品組合中產生協同效應並創造交叉銷售機會。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，我們在全球專業光模塊提供商中排名第十，並為2022年至2024年前十大廠商中收入增長最快的企業。根據同一數據來源，按2024年收入計，我們在全球及中國專業AI光模塊提供商中分別排名第六及第五。

我們專注於下一代光電互連技術。具體而言，我們主要開發：

- 1.6T、3.2T及其他下一代高速光電互連，支持AI數據中心持續增長的數據吞吐量需求；
- 先進光電互連技術，包括近封裝光學（「NPO」）及共封裝光學（「CPO」），其將光學引擎緊密或直接與電子芯片集成，以大幅減少信號損失、提高能效及支持超高頻寬密度；及

---

## 概 要

---

- PCIe AEC及PCIe AOC產品，可實現服務器及加速卡的高速光電互連，提供更高傳輸頻寬及更低功耗。

### 我們的產品

我們設計、製造並銷售光互連產品，包括(i)光模塊；(ii)AOC；及(iii)其他。截至最後實際可行日期，我們的絕大多數光互連產品用於AI數據中心。

### 光模塊

我們按其基於硅光子技術還是非硅光子技術將光模塊分類。

#### 硅光子光模塊

我們致力於開發硅光子光模塊，將硅光子芯片應用於單模400G及以上的光模塊。根據我們按傳輸速率劃分的收入明細，截至最後實際可行日期，我們光模塊銷售額的相當大一部分來源於傳輸速率達400G及以上的產品。該等產品廣泛部署於互聯網企業的AI數據中心，為大規模模型訓練、雲工作負載及骨幹網互聯提供支持。

#### 其他光模塊

我們的其他光模塊主要包括400G及800G多模式光模塊。該等產品憑藉廣泛的兼容性、先進的技術及較高的成本效益，已在多種應用場景(尤其是數據中心)中得到廣泛部署。

### AOC

AOC為光電互連產品，其將光模塊與光纖整合至單一纜線組件中，可在短距離內實現高速、低延遲的數據傳輸，且耗電量更低。AOC用於機櫃內或相鄰設備間的短距互連需求，可作為光模塊的補充，而光模塊通常用於服務器與交換機之間較長距離的數據傳輸。

---

## 概 要

---

我們根據AOC是否基於硅光子技術或非硅光子技術進行分類。

- **硅光子AOC**，目前正在開發中，由於傳統的非硅光子技術逐漸無法滿足市場對更高帶寬、更低功耗及更強整合性的需求。憑藉我們的專有技術，我們正在開發硅光子AOC，例如400G硅光子AOC、800G硅光子AOC及PCIe 6.0 AOCs。

### AEC

AEC為高速電氣互連產品，其於銅纜兩端整合具備主動均衡與放大功能的芯片，以提升信號完整性並延伸傳輸距離。在數據中心互連應用中，AEC是AOC及光模塊的補充。AOC採用光纖實現低損耗光傳輸，適用於中短距離連接；而AEC在銅質導體上實現相當的傳輸性能，特別適用於服務器內部或相鄰設備間的超短距離連接。

截至最後實際可行日期，我們的AEC產品仍處於開發中。

此外，我們亦提供其他光學元件及光引擎。

### 我們的業務模式

我們主要透過三種模式開展業務，包括(i)JDM模式；(ii)ODM模式；及(iii)自有品牌模式，以滿足客戶的多元化需求。

### 我們的JDM模式

隨著全球領先互聯網企業及雲服務提供商對定製化光模塊的需求日益增長，傳統標準化產品、分散的供應鏈以及行業的快速技術迭代已無法滿足市場對性能及可靠性的嚴苛要求。為此，我們採用了JDM模式。

憑藉與客戶建立的長期信賴及合作，我們能夠深入了解其技術路線圖及產品需求，使我們能夠共同開發迎合其特定需求的下一代光電互連產品。為此，我們已採納JDM模式。

---

## 概 要

---

於JDM模式下，我們的客戶授權我們使用其專有設計、技術規格及相關專利技術，以進行產品定製及共同開發，而我們則利用先進的研發及製造能力，交付可滿足其嚴格要求的高性能、可靠及可擴展的光模塊產品。

### 我們的ODM模式

在原始設計製造商（「ODM」）模式下，我們根據客戶的規格和要求設計和製造產品，而最終產品則以客戶自有品牌進行營銷和銷售。這種模式使我們能夠利用我們的設計和研發能力，同時受益於客戶已建立的品牌認知度和分銷網絡。

例如，自2022年以來，我們與一家全球領先的互連解決方案提供商合作，其於往績記錄期間同時是我們的前五大客戶和前五大大供應商之一。通過此次合作，我們的產品以客戶的品牌銷往海外市場，有利於我們進入新的地理市場和客戶群體。

### 我們的自有品牌模式

在我們的自有品牌（「PL」）模式下，我們直接向客戶供應標準化的光模塊和光電互連產品，並以我們自己的品牌銷售。這種模式使我們能夠接觸更廣泛的客戶群體並有效地滲透市場。

## 研發

### 研發投入

我們高度重視研發能力的構建與維護。於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，我們的研發開支分別為人民幣37.2百萬元、人民幣42.3百萬元、人民幣63.8百萬元及人民幣42.8百萬元，分別佔我們總收入的36.2%、24.1%、7.4%及6.1%。

### 研發團隊

截至2025年6月30日，我們的研發團隊擁有101名成員，佔員工總數的約30.0%。超過20.0%的研發成員平均擁有十年的全球行業經驗，包括在知名跨國企業的從業背景。

---

## 概 要

---

我們亦與領先晶圓廠及互聯網企業AI數據中心緊密合作，共同開發硅光子光模塊的集成化封裝解決方案，該等解決方案已成功應用於客戶項目，並實現標準化運作以拓展更廣泛的應用場景。

我們的團隊已在自動化、芯片—光纖耦合算法、高良率工藝優化及硅光子集成領域建立起深厚的技術積澱，使我們得以實現行業領先的生產良率及縮短的製造週期。我們亦通過逐步引入高精度耦合設備、直流測試系統等國產關鍵裝備，積極推動供應鏈本土化替代，在保障性能可靠性的同時降低了成本。

### 我們的技術

#### 產品研究及開發中的主要技術

我們在產品研究及開發中採用的關鍵技術包括但不限於以下各項：

- **硅光子芯片設計**。我們開發並維護器件庫，為硅光子技術奠定基礎。透過結合多物理場模擬(涵蓋電磁、熱與光電效應)與實際晶圓測試數據，我們持續優化器件模型以確保設計準確性與製造穩健性。憑藉器件庫，我們實現從架構定義到佈局驗證的硅光芯片設計，並與晶圓廠協作，透過閉環反饋與製程優化達成高良率晶圓製造與穩定量產。
- **光學與電氣設計**。我們整合光學與電氣設計能力，以提升耦合效率、信號完整性及整體傳輸性能。我們的專有設計庫及仿真模型支持快速迭代及高精度優化。
- **機械與結構設計**。我們專注於小型化、熱管理及模塊化集成。我們的標準化組件庫及機械設計工具實現了可擴展的生產及產品性能的一致性。
- **固件與自動化**。我們開發嵌入式固件，確保多協議互操作性、實時監控以及對光電轉換、溫度及功率管理的智能控制。

---

## 概 要

---

- **先進製造與自動化**。我們已建立自動化晶圓測試及封裝系統以及AI賦能的生產線，以確保在整個製造過程中的高良率、質量一致性及可追溯性。我們的「Wafer-In, Module-Out」集成在數字化製造環境下實現了從硅晶圓輸入到光模塊輸出的無縫流程。
- **製造工藝實驗室**。在設計驗證階段，我們針對製造工藝執行全面評估，包括工藝粘合強度評估、傅裡葉變換紅外光譜測試、粘度測試、差示掃描量熱測試以及芯片剪切測試。這些評估確保關鍵材料與工藝參數在量產前具備可靠性及穩定性。
- **可靠性實驗室**。在投入量產之前，我們會進行全面的可靠性測試，包括高溫工作壽命（「HTOL」）、溫度循環、偏壓濕熱、電磁干擾及靜電放電測試，以及其他機械可靠性評估。此外，我們已針對光電芯片與硅光子芯片建立專屬可靠性測試平台，包含芯片級HTOL及大光輸入耐久性測試。
- **系統兼容性測試平台**。在開發中產品完成設計驗證後，我們會進行全面的系統兼容性測試，以驗證產品在不同網絡環境下的性能表現。產品通過各品牌的網絡接口卡、交換器及其他專用網絡設備進行測試，確保硬件性能與固件功能在多元化的客戶網絡場景中均能實現全面兼容。

---

## 概 要

---

### 我們的優勢

我們相信下列優勢將使我們處於能夠把握未來機遇及實現持續增長的有利地位：

- (i) 創始人與團隊：具有遠見的創始人與團隊；
- (ii) 聚焦AI：我們提供支持AI計算的高速度、低功耗、低延遲光電互連產品；
- (iii) 聚焦硅光子：擁有端到端能力的行業先行者，推動下一代AI光電集成發展；及
- (iv) 業務模式：構建從上游硅光子晶圓廠至下游領先雲服務提供商的完整產業鏈。

### 我們的策略

我們擬實施下列策略：

- (i) 技術：持續推進硅光子技術與光電集成；
- (ii) 產能建設：擴充硅光子及光電共封裝產能以滿足快速增長的下游需求；
- (iii) 國內客戶：把握中國AI轉型機遇，驅動銷售持續增長；及
- (iv) 海外客戶：深化與重點合作伙伴的合作。

---

## 概 要

---

### 我們的客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括全球領先的互聯網公司及雲服務提供商。於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，我們五大客戶產生的收入分別為人民幣93.4百萬元、人民幣168.0百萬元、人民幣605.9百萬元及人民幣600.9百萬元，分別佔我們總收入的90.9%、95.8%、70.3%及86.1%。此外，於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，我們最大客戶產生的收入分別佔我們總收入的53.6%、48.3%、25.2%及29.9%。更多詳情請參閱「業務 — 我們的客戶」。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括全球及國內電子組件、光電零件、印刷電路板及半導體器件提供商。於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，我們向五大供應商的採購金額分別為人民幣46.8百萬元、人民幣157.3百萬元、人民幣683.3百萬元及人民幣464.0百萬元，分別佔我們採購總額的42.3%、62.6%、72.5%及61.3%。此外，於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，向我們最大供應商的採購額分別佔我們採購總額的16.4%、24.9%、29.8%及30.6%。更多詳情請參閱「業務 — 採購及供應鏈管理 — 供應商選擇及管理 — 我們的主要供應商」。

### 市場機會

為應對AI數據中心與硅光子技術帶來的不斷增多的市場機遇，我們建立了以高速光電互連技術為核心的產品組合，驅動AI驅動向下一代光電集成領域轉型。憑藉深厚的技術專業知識與垂直整合式研發平台，我們相信我們處在把握該快速擴張市場中的重大增長潛力的優勢地位。

#### **硅光子技術：高密度、高速及高能效光互連**

硅光子是實現高密度、高速度與高能效光互連的關鍵基礎技術，不僅構成光模塊的基礎，更為近NPO與CPO先進技術提供底層支撐。通過將光學與電子元件集成在單個芯片上，硅光子實現了光通信與電信號處理之間的密切協調，將集成電路製造的精度

---

## 概 要

---

及可擴展性與光子學的高速、低功耗優勢相結合。在硅材料的可製造性及成本優勢的支持下，硅光子實現了高水平的集成度、性能及能效，有效滿足了下一代光電集成技術日益增長的要求。

根據弗若斯特沙利文的資料，按銷售收入計，全球硅光子光模塊市場已由2020年的人民幣171億元增長至2024年的約人民幣423億元，複合年增長率為25.4%，並預期進一步增長至人民幣1,443億元，2024年至2029年複合年增長率為27.8%。根據弗若斯特沙利文的資料，中國硅光子光模塊市場預期將增長更快，於2029年達到人民幣453億元，2024年至2029年的複合年增長率為36.7%。

### **AI驅動的高速光電互連與集成需求**

自2022年以來，AI的快速增長使得全球對算力的需求大幅提升。這導致主要科技公司在世界各地建設並改善AI數據中心基礎設施。

隨着AI數據中心通過互連更多計算節點(橫向擴展)進行水平擴展，並通過增強每個計算單元內的集成(縱向擴展)進行垂直擴展，其網絡架構正趨向複雜化與數據密集型演進，需要提升帶寬、密度及能效來維持整體計算性能。

為滿足該等持續演進的需求，AI數據中心網絡正在加速向下一代光電集成技術轉變。該等技術逐步應用於產品開發，包括傳統DSP光模塊、LPO、LRO及AEC，以及更先進的NPO及CPO技術。

### **歷史財務資料概要**

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告的綜合財務資料(包括隨附附註)及本文件「財務資料」所載資料一併閱讀。

## 概 要

### 綜合損益表概要

下表載列我們於所示期間的綜合損益表主要項目：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月					
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%		
	(未經審核)											
收入.....	102,795	100.0	175,338	100.0	861,832	100.0	264,458	100.0	698,126	100.0		
銷售成本.....	(110,620)	(107.6)	(206,642)	(117.9)	(760,019)	(88.2)	(248,679)	(94)	(655,407)	(93.9)		
<b>(毛損)/毛利.....</b>	<b>(7,825)</b>	<b>(7.6)</b>	<b>(31,304)</b>	<b>(17.9)</b>	<b>101,813</b>	<b>11.8</b>	<b>15,779</b>	<b>6.0</b>	<b>42,719</b>	<b>6.1</b>		
其他收入及收益.....	13,859	13.5	6,389	3.6	3,296	0.4	2,355	0.9	7,575	1.1		
銷售及營銷開支.....	(4,572)	(4.4)	(7,675)	(4.4)	(10,131)	(1.2)	(4,680)	(1.8)	(5,443)	(0.8)		
研發開支.....	(37,190)	(36.2)	(42,266)	(24.1)	(63,797)	(7.4)	(24,063)	(9.1)	(42,798)	(6.1)		
行政開支.....	(16,148)	(15.7)	(22,492)	(12.8)	(30,850)	(3.6)	(11,145)	(4.2)	(20,686)	(3.0)		
金融資產(減值)/減值撥回淨額....	(6,348)	(6.2)	5,431	3.1	(1,973)	(0.2)	(398)	(0.2)	(4,081)	(0.6)		
其他開支及虧損.....	(189)	(0.2)	(13,072)	(7.5)	(7,559)	(0.9)	(3,123)	(1.2)	(4,434)	(0.6)		
融資成本.....	(2,129)	(2.1)	(3,252)	(1.9)	(8,537)	(1.0)	(2,405)	(0.9)	(7,702)	(1.1)		
衍生金融工具公允價值收益/ (虧損).....	333	0.3	(323)	(0.2)	—	—	—	—	—	—		
<b>除稅前虧損.....</b>	<b>(60,209)</b>	<b>(58.6)</b>	<b>(108,564)</b>	<b>(61.9)</b>	<b>(17,738)</b>	<b>(2.1)</b>	<b>(27,680)</b>	<b>(10.5)</b>	<b>(34,850)</b>	<b>(5.0)</b>		
所得稅開支.....	—	—	—	—	(157)	(0.0)	—	—	—	—		
<b>年/期內虧損.....</b>	<b>(60,209)</b>	<b>(58.6)</b>	<b>(108,564)</b>	<b>(61.9)</b>	<b>(17,895)</b>	<b>(2.1)</b>	<b>(27,680)</b>	<b>(10.5)</b>	<b>(34,850)</b>	<b>(5.0)</b>		
年/期內其他全面收益(扣除稅項).....	—	—	—	—	(321)	(0.0)	(13)	(0.0)	3	(0.0)		
<b>年/期內全面虧損總額.....</b>	<b>(60,209)</b>	<b>(58.6)</b>	<b>(108,564)</b>	<b>(61.9)</b>	<b>(18,216)</b>	<b>(2.1)</b>	<b>(27,693)</b>	<b>(10.5)</b>	<b>(34,847)</b>	<b>(5.0)</b>		

## 概 要

### 綜合財務狀況表概要

下表載列我們於所示日期綜合財務狀況表的選定資料：

	截至12月31日			截至6月30日
	2022年	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總額.....	127,368	166,320	234,700	289,131
流動資產總額.....	288,588	270,804	777,164	1,425,337
<b>資產總額</b> .....	<b>415,956</b>	<b>437,124</b>	<b>1,011,864</b>	<b>1,714,468</b>
非流動負債總額.....	23,825	38,244	117,503	119,985
流動負債總額.....	132,280	238,156	682,698	967,618
<b>負債總額</b> .....	<b>156,105</b>	<b>276,400</b>	<b>800,201</b>	<b>1,087,603</b>
流動資產淨值.....	156,308	32,648	94,466	457,719
<b>資產淨值</b> .....	<b>259,851</b>	<b>160,724</b>	<b>211,663</b>	<b>626,865</b>
股本.....	61,200	61,200	62,949	75,825
儲備.....	198,651	99,524	148,714	551,040
<b>總權益</b> .....	<b>259,851</b>	<b>160,724</b>	<b>211,663</b>	<b>626,865</b>

我們的流動資產淨值由截至2022年12月31日的人民幣156.3百萬元減少79.1%至截至2023年12月31日的人民幣32.6百萬元，主要是由於現金及現金等價物減少，部分被存貨增加所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣32.6百萬元增加189.3%至截至2024年12月31日的人民幣94.5百萬元，主要是由於(i)貿易應收款項及應收票據增加，及(ii)存貨增加，部分被計息銀行及其他借款增加所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣94.5百萬元增加384.5%至截至2025年6月30日的人民幣457.7百萬元，主要是由於(i)現金及現金等價物增加，及(ii)貿易應收款項及應收票據增加，部分被貿易應付款項及應付票據增加所抵銷。



## 概 要

### 主要財務比率

下表載列我們於所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日			截至6月30日	
	2022年	2023年	2024年	2025年	
流動比率 <sup>(1)</sup> .....	2.2	1.1	1.1	1.5	
速動比率 <sup>(2)</sup> .....	1.7	0.6	0.7	1.1	
負債權益比率 <sup>(3)</sup> .....	31.7%	99.7%	247.4%	91.8%	

  

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
毛利率 <sup>(4)</sup> .....	(7.6)%	(17.9)%	11.8%	6.0%	6.1%

附註：

- (1) 流動比率按流動資產總額除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率按流動資產總額減存貨除以流動負債總額計算。
- (3) 負債權益比率按總負債(即計息銀行及其他借款的賬面餘額)除以總權益再乘以100%計算。
- (4) 毛利率指毛利佔總收入的百分比。

更多詳情請參閱「財務資料 — 主要財務比率」。

### 風險因素

我們認為，我們的營運涉及若干風險與不確定性，其中有些風險與不確定性乃是我們無法控制。我們將該等風險與不確定性歸類為：(i)與我們的業務及行業有關的風險，(ii)與我們經營所在司法權區有關的風險，及(iii)與[編纂]有關的風險。該等風險包括(其中包括)以下各項：

- 倘採用我們產品的終端市場增長波動，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 我們在經營所處行業面臨激烈競爭。倘無法有效競爭，我們的經營業績及財務狀況或會受到重大不利影響。

---

## 概 要

---

- 倘我們無法持續優化產品組合以適應技術發展與客戶偏好，且無法及時以具成本效益的方式獲得市場認可，我們的發展前景及經營業績可能會受到重大不利影響。
- 我們的成功在很大程度上取決於我們的研發能力。倘無法推動我們的技術進步、提升我們的研發能力或達成我們的預期的研發里程碑，均可能削弱我們的競爭力與盈利能力。
- 任何產品缺陷或質量不穩定均可能對我們的業務及聲譽造成不利影響。
- 我們收入的相當大比例源自五大客戶。未能獲取新客戶或留住現有客戶可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 原材料價格上漲或供應短缺，均可能擾亂我們的供應鏈、增加生產成本，並延遲向客戶交付產品。
- 我們依賴多家主要供應商，任何供應中斷或供應商關係惡化均可能對我們的業務及經營業績造成不利影響。
- 倘我們失去任何核心管理成員或其他合資格及經驗豐富的人員，我們有效管理與執行運營以及實現戰略目標的能力可能會受到損害。
- 我們於往績記錄期間產生淨虧損。無法有效管理我們的增長可能會對我們的業務、未來前景及財務狀況造成不利影響。

### 業務可持續性

我們預期透過(i)持續提收入增長、(ii)提升成本效益及(iii)審慎管理運營開支進一步改善財務表現並實現盈利。

---

## 概 要

---

### **驅動持續收入增長**

於往績記錄期間，我們的收入顯著成長，並在2022年至2024年間錄得全球前十大專業光模組供應商中最快的收入增長。

我們預期透過以下舉措維持此增長動能：

### **與市場同步成長**

自2022年起，人工智能的快速崛起顯著推升全球對算力的需求，驅動主要科技公司在全球範圍內擴充與升級AI數據中心基礎設施。隨著AI數據中心規模擴大，其網絡架構趨向複雜化與數據密集型，需要更高的帶寬、密度與能源效率以維持整體計算性能。

為滿足這些不斷演進的需求，AI數據中心網絡正加速向下一代光電集成技術過渡。光電互連產品(特別是基於硅光子的產品)已成為支持此輪AI驅動技術革新的關鍵要素，為整個產業創造龐大成長機遇。

### **深化與現有客戶的協作**

於往績記錄期間，我們憑藉端到端技術能力，成為中國領先互聯網公司的聯合設計製造(JDM)合作夥伴，從而建立起高市場准入門檻。JDM模式使我們能深度參與客戶產品開發全過程，將研發路線圖與其最先進技術需求對齊。此種緊密協作強化了長期客戶的黏性與重複性收入，同時使我們位於下一代技術發展的前沿，確保新產品的市場適配性與品質。

### **持續創造價值與提升硅光子及光電合封產能以滿足客戶需求**

我們通過持續創新、性能優化及滿足客戶不斷演進需求的定製化解決方案，不斷為客戶創造價值。隨著客戶AI算力規模擴張，其對我們產品的需求將相應增長，為首次銷售後帶來持續性與增量性收入機會。

---

## 概 要

---

我們的下一代研發工作(包括即將進入客戶取樣的1.6T硅光子光模塊，以及專為基於硅光子的NPO及CPO應用設計的3.2T及6.4T光電芯片)具備高度技術複雜性，對行業形成顯著挑戰，從而構築起實質性准入壁壘。這些進展增強了對頭部客戶的吸引力，且鞏固我們在光電互連行業的技術前沿地位。

### 管理成本

於往績記錄期間，我們實現毛利潤的顯著提升，主要由於銷售成本增長幅度低於收入增長幅度。

隨著產能規模擴大，我們透過集中採購與材料來源優化獲得規模經濟效應，有效降低單位生產成本並提升整體製造效率。

此外，我們計劃進一步運用擴充的產能開拓海外市場。海外客戶普遍具有更高的價格接受度，此舉預期將提升整體盈利能力，並進一步強化我們的成本效益優勢。

透過這些努力，我們的毛利率由2022年的負9.9%提升至2024年的11.6%，反映產品組合的優化(受利潤率較高的硅光子光模塊佔比增加所驅動)以及營運效率提升與成本管控的強化。

### 提升效率

我們維持嚴格的成本控制，並隨著業務擴張實現顯著的營運槓桿。我們的總營運支出佔收入的百分比由2022年的56.3%下降至2024年的12.2%，並進一步下降至截至2025年6月30日止六個月的9.9%，反映出成本效率的提高。這一改善得益於JDM模式下銷售生產力和客戶集中度的提高，銷售及營銷開支持續減少，研發產出商業化的加強帶來的研發效率的提高，以及通過數字化的內部控制和財務系統優化管理職能。

---

## 概 要

---

### 法律訴訟及不合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟(包括任何破產或接管程序)。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

### 單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，胡博士、蘇州海怡及蘇州海旭共同於本公司已發行股份總數中擁有21.11%的權益。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且概無根據[編纂]前購股權計劃發行股份)，彼等將共同於本公司已發行股份總數中擁有[編纂]%的權益，並將繼續為單一最大股東集團。

### [編纂]前投資

我們已與[編纂]前投資者完成[編纂]前投資。有關[編纂]前投資者的身份及背景以及[編纂]前投資主要條款的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」。

[編纂]

---

## 概 要

---

### [編纂]

#### 股息及股息政策

自我們註冊成立以來，於往績記錄期間，我們或我們的任何子公司概無派付或宣派任何股息。

我們並無維持正式的股息政策或固定派息率，且我們可能以現金或董事會認為適當的其他方式分派股息。任何建議股息分派須經董事會酌情決定並經股東批准。根據組織章程細則，董事會可在計及我們的經營業績、財務狀況、經營需求、資本需求、股東權益及董事會可能認為相關的任何其他條件後，建議日後分派股息。我們無法保證我們將能夠於任何年度派發上述金額或任何金額的股息，甚至根本無法派發股息。宣派及派付股息亦可能受到法律限制以及本公司與我們的子公司已訂立或日後可能訂立的貸款或其他協議的限制。根據適用的中國法律，我們只能以可分配利潤（即除稅後利潤減累計虧損彌補額以及法定資本公積金的必需分配額）派付股息。我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間，由於累計虧損而並無可分配利潤，我們無法向股東派付股息。此外，未來我們可能並無足夠或任何可分配利潤可供我們向股東分派股息，包括我們盈利的年度。詳情請參閱「財務資料—股息」。

---

## 概 要

---

### 未來計劃及[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]的中位數)，經扣除[編纂]及[編纂]以及我們就[編纂]已支付及應支付的估計[編纂]，我們將收取[編纂][編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- [編纂]淨額的約[51]%(或[編纂]港元)預期用於擴充我們光模塊及其他光電互聯產品的產能，並提升我們各產品線的自動化水平。
- [編纂]淨額的約[37]%(或[編纂]港元)預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發。
- [編纂]淨額的約[2]%(或[編纂]港元)預期用於未來三年內的業務推廣及市場拓展措施。
- [編纂]淨額的約[10.0]%(或[編纂]港元)預期用於營運資金及一般企業用途。

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

### [編纂]

我們的[編纂]主要包括(i)[編纂]，如[編纂]及[編纂]，及(ii)非[編纂]相關開支，包括就法律顧問及申報會計師提供[編纂]及[編纂]相關服務向其支付的專業費用，以及其他費用及開支。假設悉數支付酌情獎勵費，[編纂]的估計[編纂]總額(基於[編纂]的中位數計算及假設[編纂]未獲行使)約為[編纂]港元，約佔我們[編纂]總額的[編纂]%。相關估計[編纂]總額中，我們預計將支付[編纂][編纂]港元、法律顧問及申報會計師專業費用[編纂]港元及其他費用及開支[編纂]港元。我們的估計[編纂]金額[編纂]港元，約佔我們[編纂]的[編纂]%，已經或預計於損益表支銷，其餘金額[編纂]港元預計將於[編纂]後直接確認為自

---

## 概 要

---

權益扣減。我們分別於2022年、2023年及2024年的綜合損益及其他全面收益表中並無確認任何[編纂]。

### [編纂]

#### [編纂]前購股權計劃

我們於2025年10月23日採納[編纂]前購股權計劃。有關詳情，請參閱「法定及一般資料」。截至最後實際可行日期，尚未行使購股權項下的相關股份數目為3,000,000股股份，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]%（假設(1)[編纂]未獲行使；及(2)概無根據[編纂]前購股權計劃發行股份）。假設所有尚未行使購股權獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後股東的股權（假設(1)所有購股權均獲行使；(2)[編纂]未獲行使；及(3)概無根據[編纂]前購股權計劃進一步發行股份）及我們的[編纂]將被攤薄約[編纂]%。

#### 近期發展及無重大不利變動

董事已確認，直至本文件日期，自2025年6月30日（即我們的最新經審核財務報表的期末）以來，我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年6月30日以來，概無發生任何對本文件附錄一所載會計師報告列示的資料產生重大影響的事件。